

甲固®
JIAGU



电子胶粘剂

产品应用指南

郑州华宇科技有限公司
ZHENGZHOU HUAYU TECHNOLOGY CO.,LTD.

河南瑞朗达新材料有限公司
HENAN RALEAD NEW MATERIAL CO.,LTD.

公司简介 Company Profile

郑州华宇科技有限公司，始于1997年，是专注胶粘剂、密封胶研发生产、销售服务的国家高新技术企业。宝丰高新区工厂占地3万多平方米，建筑面积4万多平方米，拥有先进的自动化生产线，设计年产能5万吨。

甲固®瑞朗达®二十多年创新发展，产品涵盖有机硅、改性硅烷、聚氨酯、环氧、厌氧、丙烯酸酯、CR、SBS、PVC、ABS等十大材质，300多个产品，广泛应用于航空航天、轨道交通、汽车车辆、电子电器、新能源、建筑幕墙、门窗装饰等多个领域。

公司拥有粘接技术中心及知识产权，为客户提供专业的产品和应用解决方案；产品获得了国内外众多权威机构的认证，获得多项发明专利、科技成果及奖励证书。2015年在上海股权交易中心挂牌上市，证券代码：204322。

与胶结缘，粘接你我！公司秉承“工业胶品质，建筑胶价格”的经营理念，满足客户需求，与客户共同发展！

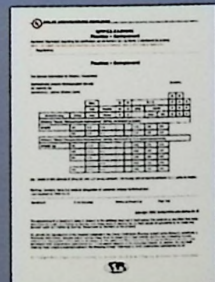
Zhengzhou Huayu Technology Co., Ltd., founded in 1997, is a national high-tech enterprise focusing on the R & D, production, sales and service of adhesives and sealants. Baofeng high tech Zone factory covers an area of more than 30000 square meters and a construction area of more than 40000 square meters. It has an advanced automatic production line and a design annual production capacity of 50000 tons.

JIAGU® RALEAD® With more than 20 years of innovation and development, the products cover ten materials such as silicone, modified silane, polyurethane, epoxy, anaerobic, acrylate, CR, SBS, PVC and ABS, and more than 300 products. They are widely used in aerospace, rail transit, automobile and vehicle, electronics and appliances, new energy, building curtain wall, door and window decoration and other fields.

The company has a bonding technology center and intellectual property rights to provide customers with professional products and application solutions; The products have been certified by many authoritative institutions at home and abroad, and have obtained a number of invention patents, scientific research achievements and award certificates. In 2015, it was listed on Shanghai equity trading center with securities code of 204322.

Bond with glue, bond you and me! Adhering to the concept of "industrial glue quality, construction glue price", the company meets the needs of customers and develops together with customers!

企业荣誉 >>> 诚以立信 质以建业

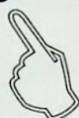


甲固[®]

JIAGU

www.huayukeji.com

流企业 造甲固好胶



产品目录 Contents

● 改性有机硅 Modified silane

改性有机硅粘接胶	1
低模量硅烷密封胶	2

● 有机硅材料 Silicone sealant

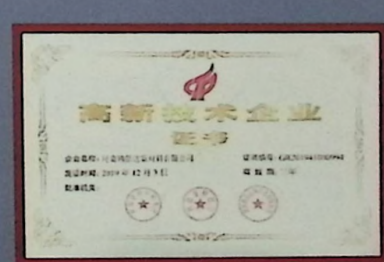
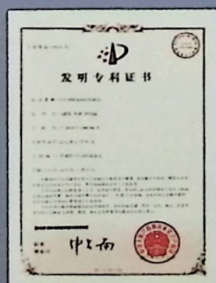
有机硅导热胶	3
低粘度三防漆	4
不流淌有机硅密封胶	5
半流淌有机硅密封胶	6
单组分有机硅灌封胶	7
双组份有机硅灌封胶	8
加成型有机硅灌封胶	9

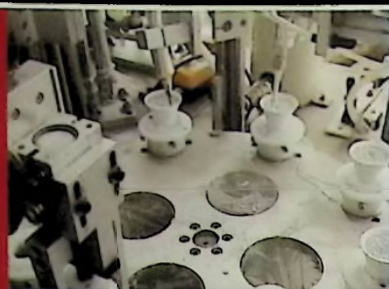
● 聚氨酯材料 PU adhesive

双组份聚氨酯灌封胶	10
-----------------	----

● 环氧树脂胶 Epoxy adhesive

双组分环氧灌封胶	11
增韧快固环氧胶	12
单组份环氧灌封胶	13
单组份环氧邦定胶	14
单组份环氧结构胶	15
SMT环氧贴片红胶	16





改性有机硅粘接胶

特点用途

本品为单组份改性有机硅材料，不含溶剂、无异氰酸酯、固化后抗污染、绿色环保，耐热性和防老化能力俱佳等优点。本产品符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》环保要求，符合欧盟ROHS和REACH环保标准。为满足深层固化，可生产1:1双组份粘接胶。

HY938Paste

触变膏状，用于LED灯具、电子元器件、机电零部件的密封粘接。

HY938Half Flowing

半流淌，用于LED灯具、电子元器件的密封粘接固定。

HY938Flow

自流平，用于LED灯具、电子元器件、机电零部件的灌封。

操作工艺

- 1.粘接表面要无油渍、无灰尘、无杂质等；
- 2.按工艺要求将施胶嘴切成所需尺寸形状；
- 3.切除密封胶封口，装上胶嘴，装入胶枪内；
- 4.将密封胶均匀涂在接缝处，最薄处大于1mm；使用气动枪时气压控制在0.2~0.4Mpa。
- 5.产品在表干之后可以利用传统的方法进行修整，把多余的胶清掉。

注意事项

- ◆避免在5℃以下及湿度小于20%的环境下施工；
- ◆气动压力严禁超过0.5 Mpa，超过时气体会进入硬包装管内，出现胶体气泡问题；
- ◆由于涂料含高溶剂成分会导致胶表面变软，为了获得最佳的外观和性能，胶体固化24小时之后进行着色；
- ◆阴凉干燥处密封贮存，贮存期6个月。过期后经检验合格仍可使用。



主要技术指标

牌 号	HY938Paste	HY938Half Flowing	HY938Flow
胶料外观	白色膏状	白色半流淌	黑色自流平
下垂度(mm)	≤2	≤6	--
密度(g/cm3)	1.4 ± 0.2	1.4 ± 0.2	1.2 ± 0.2
表干时间(min)	50	30	30
固化速度(mm /24h)	2.0~3.0	2.0~3.0	2.0~3.0
拉伸剪切强度(Mpa)	≥1.0	≥0.8	≥0.5
抗拉强度(Mpa)	≥1.0	≥0.8	≥0.5
拉断伸长率(%)	≥150	≥150	≥150
撕裂强度(KN /m)	≥6	≥5	≥5
硬度 (邵氏A)	20~60	20~60	20~60
导热系数(W/m · K)	0.2~0.5	0.2~0.5	0.2~0.5
耐温范围 (℃)	-40~120	-40~120	-40~120
包装规格	2.6L桶, 25kg桶, 400ml双管		

※注：所有机械性能和电性能均在25℃。湿度55%条件下固化7天后所测。

低模量硅烷密封胶



特点用途

本品为改性硅烷材料，不含溶剂、固化后抗污染、绿色环保，低模量、高延伸率、耐热性和防老化能力俱佳等优点。本产品符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》环保要求，符合欧盟ROHS和REACH环保标准。为满足深层固化，可生产1:1双组份密封胶。

施工工艺

1. 施工前，要无油渍、无灰尘、无杂质；
2. 将施胶嘴切成所需尺寸形状；
3. 将施胶嘴封口，装上胶嘴，装入胶枪内；
4. 将胶均匀涂在接缝处，最薄处大于1mm；使
5. 施工时气压控制在0.2~0.4Mpa。
6. 施工完之后可以利用传统的方法进行修整，把多余的胶清掉。

注意事项

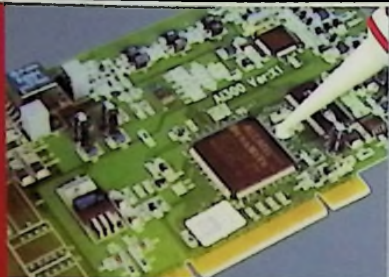
- ◆ 避免在5℃以下及湿度小于20%的环境下施工；
- ◆ 气动压力严禁超过0.5 Mpa，超过时气体会进入硬包装管内，出现胶体气泡问题；
- ◆ 由于涂料含高溶剂成分会导致胶表面变软，为了获得最佳的外观和性能，胶体固化24小时之后进行着色；
- ◆ 阴凉干燥处密封贮存，贮存期6个月。过期后经检验合格仍可使用。



主要技术指标

牌 号	HY939Paste	HY939Half Flowing	HY939Flow
胶料外观	灰色膏状	灰色半流淌	灰色自流平
下垂度(mm)	≤2	≤6	--
密度(g/cm3)	1.4 ± 0.2	1.4 ± 0.2	1.2 ± 0.2
表干时间(min)	20~50	20~50	20~50
固化速度(mm /24h)	2.0~3.0	2.0~3.0	2.0~3.0
抗拉强度(Mpa)	≥0.7	≥0.5	≥0.4
拉断伸长率(%)	≥650	≥750	≥850
弹性回复率(%)	≥70	≥70	≥70
拉伸模量(MPa)	≤0.4	≤0.4	≤0.4
定伸粘结性	无破坏	无破坏	无破坏
耐温范围(℃)	-40~120	-40~120	-40~120
包装规格	2.6L桶, 25kg桶, 400ml双管		

※注：所有机械性能和电性能均在25℃。湿度55%条件下固化7天后所测。



有机硅导热胶

特点用途

单组分室温固化的中性有机硅材料，耐高低温，具有优良的耐老化性、柔韧性、绝缘性，防潮、抗震、耐电晕、抗漏电。立面不流淌、可粘接钢铁、玻璃、PVC、ABS等材料。适用于电子元器件的导热粘接密封。

HY595D导热型硅橡胶

代替导热硅脂，用于CPU与散热器等的填充粘接。

HY595HD导热型硅橡胶

用于要求较高导热性的晶闸管智能模块与散热器的填充粘接。

HY595H导热型硅橡胶

用于大功率电器模块与散热器之间的填充粘接。

操作工艺

清洁表面：将被粘物表面整理干净，除去锈迹、灰尘、水分及油污；

施胶：刺开铝封口，将胶液挤到已清理干净的表面，使之分布均匀；

粘接密封：施胶后20分钟内必须进行粘接，将被粘面合拢固定即可；

固化：室温固化24小时达到最高强度。夏季温度高，固化会快一些；冬季温度低，固化会慢一些。

注意事项

- ◆ 硅橡胶吸潮固化，未用完的胶应密封保存。
- ◆ 密封贮存于阴凉干燥处，贮存期9个月。

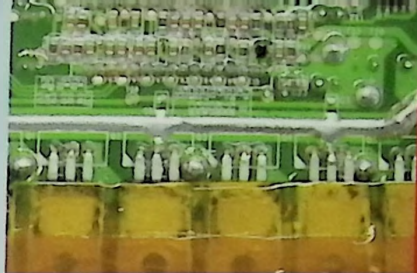


主要技术指标

性能指标	HY595D	HY595HD	HY595H
外观颜色	白色	白色	白色
粘度 (Pa·S)	触变膏状	触变膏状	触变膏状
密度 (g/cm³)	1.3~1.7	1.3~1.7	1.3~1.7
表干时间 (min)	20~40	20~40	20~40
抗拉强度 (MPa)	0.7~1.5	0.7~1.5	0.7~1.5
延伸率 (%)	200~300	200~300	200~300
邵氏硬度 (Shore A)	30~50	30~50	30~50
剪切强度 (MPa)	0.7~1.5	0.7~1.5	0.7~1.5
介电强度 (kv/mm)	20	20	20
损耗因子 (@60Hz)	0.001	0.001	0.001
体积电阻 (Ω·cm)	2×10^{14}	2×10^{14}	2×10^{14}
工作温度范围 (°C)	-60~280	-60~280	-60~280
线收缩率 (%)	0.5	0.5	0.5
导热系数 (W/M·K)	0.8	1.2	2.0
包装规格	100ml/管, 100管/箱		

※注：所有机械性能和电性能均在25℃、湿度55%条件下固化7天后所测。

低粘度三防漆



特点用途

本品为低粘度中性高分子复合材料，单组分，易于喷涂、浸涂及刷涂。具有良好的耐高低温性能；其固化后成一层透明保护膜，具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。广泛应用于电子元器件的表面披覆保护。

施工工艺

- 1.将胶液放入浸桶中，进行浸涂，线路板或元器件浸入胶液不宜太快，以免产生气泡。
- 2.喷涂时，将胶液装入喷壶中，进行喷涂。喷涂结束后，可用稀释剂清洗喷壶。
- 3.涂刷时，可用稀释剂稀释。稀释剂的加入量应根据胶液的粘度低，涂胶的厚度薄；反之，胶的粘度低，涂胶的厚度厚。稀释剂的加入量建议为20%。

注意事项

- ◆未用完的胶液应密封保存。再次使用时，若封口处或者表面有结皮，将其去除即可，不影响正常使用。
- ◆施工现场应有良好的通风设施。
- ◆阴凉干燥处密封贮存，贮存期6个月。过期后经检验合格仍可使用。

HY5901有机硅三防漆

脱肟硅胶，用于LED电子元器件涂覆保护，不适宜铜、PC材料。

HY590K丙烯酸三防漆

改性丙烯酸，不含硅、酮、酚等材料，UV光下蓝色，便于检测。

HY590P聚氨酯三防漆

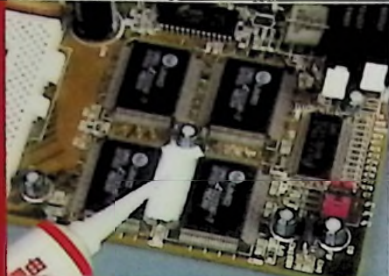
改性聚氨酯，不含硅、酮、酚等材料，UV光下蓝色，便于检测。



主要技术指标

性能指标	HY5901	HY590K	HY590P
颜色	透明	透明	透明
主要成分	脱肟硅胶	改性丙烯酸	改性聚氨酯
固含量 (%)	100	>35	100
粘度 (mPa·S)	400~800	400~800	400~800
密度 (g/cm ³)	1.0±0.1	1.0±0.1	1.0±0.1
表干时间 (min)	10~30	3~10	3~10
全固时间 (h,25℃)	24	80℃3分钟	80℃3分钟
抗拉强度 (Mpa)	1.0	4.5	4.5
扯断伸长率 (%)	100	30	100
硬度 (shore A)	20	65	65
剪切强度 (Mpa)	1.0	2.5	2.5
剥离强度 (N/mm)	>6	>6	>6
介电强度 (kV/mm)	25	50	50
介电常数 (1.2MHz)	3.0	2.7	2.7
损耗因子 (1.2MHz)	5×10 ⁻³	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³
体积电阻 (Ω·cm)	2×10 ¹⁴	1×10 ¹⁴	1×10 ¹⁴
使用温度 (℃)	-50~250	-50~150	-50~150
包装规格	1L/听, 15L/桶		

※注：所有机械性能和电性能均在25℃。湿度55%条件下固化7天后所测。



不流淌有机硅密封胶

特点用途

甲固[®]橡胶是一类单组分室温固化的中性有机硅材料，耐高低温，具有优良的耐老化性、柔韧性、绝缘性，防潮、抗震、耐电晕、抗漏电。立面不流淌、可粘接钢铁、玻璃、PVC、ABS等材料。适用于电子元器件等的各类粘接密封。

HY593硅橡胶密封胶

脱肟型、黑色，适用于各类电子元器件的密封粘接。

HY594硅橡胶密封胶

脱肟型、透明，适用于有透明要求的线路板等的防潮粘接密封。

HY595硅橡胶密封胶

脱肟型、白色，适用于冰箱、太阳能组件、电子元器件等的防潮粘接密封。

HY583硅橡胶密封胶

脱醇型、各色，对聚碳酸酯（PC）、铜等材料不腐蚀，适用于各类电子元器件的密封粘接。

操作工艺

清洁表面：将被粘物表面整理干净，除去锈迹、灰尘、水分及油污。

施 胶：切开胶嘴，放入胶枪中，将胶液挤到已清理干净的表面，使之分布均匀。

粘接密封：施胶后20分钟内必须进行粘接，将被粘面合拢固定即可。

固 化：室温固化24小时达到最高强度。夏季温度高，固化会快一些；冬季温度低，固化会慢一些。

注意事项

- ◆ 硅橡胶吸潮固化，未用完的胶应密封保存。
- ◆ 密封贮存于阴凉干燥处，贮存期9个月。

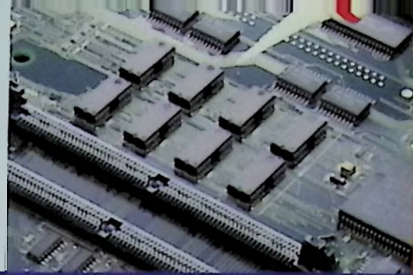


主要技术指标

性能指标	HY593	HY594	HY595	HY583
外观颜色	黑色	透明	白色	各色
粘度 (Pa·S)	触变膏状	触变膏状	触变膏状	触变膏状
密度 (g/cm ³)	1.1~1.4	0.9~1.1	1.1~1.4	1.1~1.4
表干时间 (min)	10~30	10~30	10~30	5~15
抗拉强度 (MPa)	1.0~2.0	1.0~2.0	1.0~2.0	1.0~2.0
延伸率 (%)	300~500	200~350	300~500	200~300
邵氏硬度 (Shore A)	30~50	20~30	30~50	25~35
剪切强度 (MPa)	1.0~2.0	1.0~2.0	1.0~2.0	1.0~2.0
介电强度 (kv/mm)	20	20	20	20
损耗因子 (1.2MHz)	0.001	0.001	0.001	0.001
体积电阻 (Ω·cm)	2×10 ¹⁴	2×10 ¹⁴	2×10 ¹⁴	2×10 ¹⁴
工作温度范围 (℃)	-60~250	-60~250	-60~250	-60~250
线收缩率 (%)	0.3	0.3	0.3	0.3
导热系数 (W/M·K)	0.3	0.3	0.3	0.3
包装规格	100ml/管, 100管/箱; 300ml/筒, 25筒/箱			

※注：所有机械性能和电性能均在25℃、湿度55%条件下固化7天后所测。

半流淌有机硅密封胶



特点用途

华宇有机硅密封胶是一类单组分室温固化的中性有机硅材料，半流淌，固化后为弹性体。具有优异的抗冷热交变性能、耐老化性、柔韧性、绝缘性，防潮、抗震、耐电晕、抗漏电。是传统703、704硅橡胶的换代产品。适用于电子线路板上部分电子元器件的局部封装保护。

HY591W硅橡胶密封胶

脱脂型、白色，电器模块等电子元器件的封装。

HY591B硅橡胶密封胶

脱脂型、黑色，电子元器件、线路板、继电器、微波炉等的粘接密封。

HY591T硅橡胶密封胶

脱脂型、半透明，有透明要求的各类电子元器件的封装保护。

HY581硅橡胶密封胶

脱醇型、各色，对聚碳酸酯（PC）、铜等材料不腐蚀，用于各类电子元器件的封装保护。

操作工艺

清洗 将密封物表面整理干净，除去锈迹、灰尘、水分及油污。

施胶 撕开胶管盖帽，刺开封口，将胶液涂到已清理干净的表面，使之自然流成半圆形。

固化 胶液吸收空气中的潮气，表面开始固化，逐渐向深层固化，在24小时（室温及60%相对湿度）内固化深度为3~4mm。

夏季温度高，湿度大，固化会快一些；冬季温度低，湿度小，固化会慢一些。

注意事项

- ◆ 硅橡胶吸潮固化，未用完的胶应密封保存。
- ◆ 密封贮存于阴凉干燥处，贮存期9个月。



主要技术指标

性能指标	HY591W	HY591B	HY591T	HY581
外观颜色	白色半流体	黑色半流体	半透明半流体	各色半流淌
密度 (g/cm ³)	1.15	1.15	1.02	1.15
表干时间 (min)	10~30	10~30	10~30	5~15
抗拉强度 (MPa)	1.0	1.0	1.0	1.0
延伸率 (%)	200~300	200~300	200~300	200~300
邵氏硬度 (Shore A)	30~50	30~50	20~30	20~30
剪切强度 (MPa)	≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5
介电强度 (kv/mm)	≥20	≥20	≥20	≥20
损耗因子 (1.2MHz)	0.001	0.001	0.001	0.001
体积电阻 (Ω·cm)	1×10 ¹⁵	1×10 ¹⁵	1×10 ¹⁵	1×10 ¹⁵
工作温度范围 (℃)	-60~250	-60~250	-60~250	-60~250
线收缩率 (%)	0.3	0.3	0.3	0.3
包装规格	100ml/管, 100管/箱; 300ml/筒, 25筒/箱			

※注：所有机械性能和电性能均在25℃、湿度55%条件下固化7天后所测。

单组分有机硅灌封胶

特点用途

华宇有机硅灌封胶是一类单组分室温固化的中性有机硅材料，低粘度，自流平，固化后为弹性体。耐高低温，具有优良的耐老化性、柔韧性、绝缘性，防潮、抗震、耐电晕、抗漏电。适用于小型或薄层（灌封厚度小于7MM）的电子元器件、线路板、传感器、继电器等的灌封保护。

HY592T硅橡胶密封剂

脱肟型、透明，各种电子元件的灌封。

HY592B硅橡胶密封剂

脱肟型、黑色，发光二极管等电子元件的灌封。

HY592W硅橡胶密封剂

脱肟型、白色，电器模块等电子元件的灌封。

HY582硅橡胶密封剂

脱醇型、透明，对聚碳酸酯（PC）、铜等材料不腐蚀，各种电子元件的灌封。

操作工艺

清洁表面：将被灌封物表面整理干净，除去锈迹、灰尘、水分及油污。

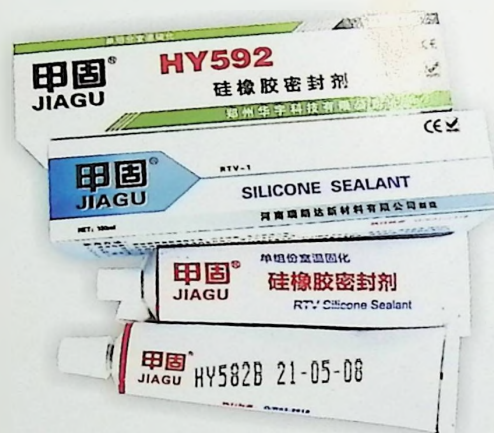
施胶：拧开胶管盖帽，刺开封口，将胶液挤到已清理干净的表面，使之自然流平。

固化：胶液吸收空气中的潮气，表面开始固化，逐渐向深层固化，在24小时（室温及60%相对湿度）内固化深度为3~4mm。

夏季温度高，湿度大，固化会快一些；冬季温度低，湿度小，固化会慢一些。

注意事项

- ◆厚度超过6mm的灌封应选择华宇双组分灌封胶。
- ◆硅橡胶吸潮固化，未用完的胶应密封保存。
- ◆密封贮存于阴凉干燥处，贮存期9个月。



主要技术指标

性能指标	HY592T	HY592B	HY592W	HY582
外观颜色	透明流体	黑色流体	白色流体	各色流体
粘度 (Pa·S)	6~10	8~15	8~15	6~10
密度 (g/cm ³)	1.0	1.1	1.1	1.0
表干时间 (min)	10~30	10~30	10~30	5~20
抗拉强度 (MPa)	0.8	1.0	1.0	0.7
延伸率 (%)	200~300	200~300	200~300	150~200
邵氏硬度 (Shore A)	20~30	20~30	20~30	15~25
剪切强度 (MPa)	≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5
介电强度 (kv/mm)	≥20	≥20	≥20	≥20
损耗因子 (1.2MHz)	0.001	0.001	0.001	0.001
体积电阻 (Ω·cm)	1×10 ¹⁵	1×10 ¹⁵	1×10 ¹⁵	1×10 ¹⁵
工作温度范围 (℃)	-60~250	-60~250	-60~250	-60~250
线收缩率 (%)	0.3	0.3	0.3	0.3
包装规格	100ml/管, 100管/箱; 300ml/筒, 25筒/箱			

※注：所有机械性能和电性能均在25℃、湿度55%条件下固化7天后所测。

双组分有机硅灌封胶



特点用途

HY584有机硅灌封胶是一类双组分、室温固化、缩合脱醇型的有机硅灌封材料，自流平、耐高低温，具有优良的耐老化性、柔韧性、绝缘性，防潮、抗震。适用于电子元器件的各种浇注粘接、密封。完全符合欧盟ROHS指令要求。

操作工艺

混合前，将A、B组分在各自的容器内充分搅拌、摇晃均匀。
按配比称取A、B组分，放入混合罐中，充分搅拌混合均匀。
将混合好的胶液用注射器或点胶枪点胶，配胶量不宜超过容器的1/2，
将胶液点在产品表面，待胶液固化后，即可取出。
混合好的胶液应尽快灌注到需要灌封的产品中。
灌封好的产品应在室温下固化，表干后方可进入下道工序，
完全固化时间为24小时。

注意事项

- ◆ A组分若有沉淀或分层，应搅拌均匀后使用，不影响产品性能。
- ◆ 混合好的胶应一次用完，未用完的胶料和固化剂应密封保存。
- ◆ 密封贮存于阴凉干燥处，贮存期六个月。
- ◆ 包装规格：11kg/套。

主要技术指标

产品牌号	HY584T	HY584P	HY584Z	HY584H	HY584ZF
胶料颜色A/B	无色透明	白色等/透明	白色等/透明	灰白色/透明	白色等/透明
密度(g/cm ³)A/B	0.95~1.05	1.3/1.03	1.3/1.03	1.3/1.03	1.3/1.03
A组分粘度(Pa.S)	1.5~2.5	5.5~11	7.5~13	7.5~13	7.5~13
B组分粘度(Pa.S)	0.01~0.1	0.01~0.1	0.01~0.1	0.01~0.1	0.01~0.1
混合后粘度 (Pa.S)	0.5~1.5	2.5~5.5	2.5~6.5	2.5~6.5	2.5~6.5
可操作时间(min)	30~90	40~120	40~120	40~120	40~120
完全固化时间(h)	24	24	24	24	24
邵氏硬度 (Shore A)	10~30	20~40	20~50	20~50	20~50
剪切强度 (MPa)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
导热系数 (W/m·k)	0.3	0.3	0.7	2.0	0.7
阻燃等级 (UL94)	HB	HB	V0	HB	V0
防霉性 (级)	/	/	/	/	0
介电强度 (kv/mm)	≥18				
体积电阻 (Ω·cm)	≥1.0×10 ¹⁴				
适用温度 (℃)	-60~200				

※注：所有机械性能和电性能均在25℃、湿度55%条件下固化7天后所测。

HY584T透明型灌封胶

适用于电子元器件有透明要求的灌封、密封。

HY584P通用型灌封胶

适用于电子元器件的灌封、密封。

HY584Z导热阻燃灌封胶

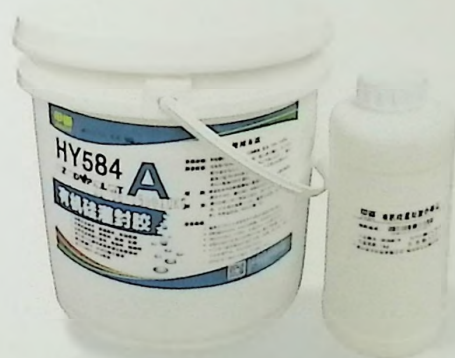
适用于电子元器件有导热阻燃要求的各种灌封、密封。

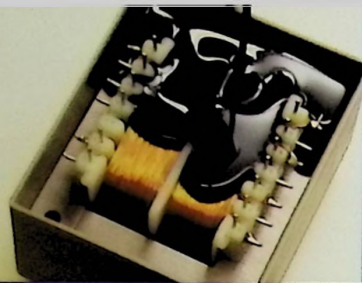
HY584H高导热型灌封胶

适用于有高导热性要求的电子元器件灌封、密封。

HY584ZF导热阻燃防霉胶

适用于有导热阻燃防霉要求的电子元器件灌封、密封。





加成型有机硅灌封胶

特点用途

HY585适用于大功率及散热要求高的电子元器件绝缘及防水。本品在固化反应中不产生任何副产物，可以应用于金属表面及PC、PP、ABS、PVC等材料。完全符合欧盟ROHS指令要求。

HY585O硅凝胶

俗称果冻胶，适用于各种电子元器件的密封保护，尤其精密电子元器件。

HY585T透明型灌封胶

适用于电子元器件有透明要求的灌封、密封。

HY585D导热阻燃灌封胶

适用于电子元器件有导热阻燃要求的灌封、密封。

HY585H高导热型灌封胶

适用于有高导热性要求的电子元器件灌封、密封。

操作工艺

- 1.混合前，首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。
- 2.按配比称取A、B组分，放入混合罐中，充分搅拌混合均匀。最好抽真空脱泡10分钟左右，配胶量不宜超过容器的1/2，否则在脱泡时胶会溢出。
- 3.将混合好的胶料尽快灌注到需要灌封的产品中。
- 4.灌封工件可选择室温或者加热固化。60~80℃下30分钟即可固化。

注意事项

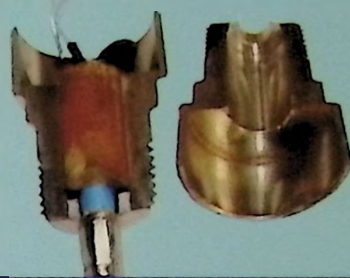
- ◆A、B组分若有沉淀或分层，应搅拌均匀后使用，不影响产品性能。
- ◆本品不能接触有机锡化合物、硫磺、硫化物、胺类化合物等产品，否则可能不固化。
- ◆密封贮存于阴凉干燥处，贮存期六个月。
- ◆包装规格：20KG/套。



主要技术指标

产品牌号	HY585O	HY585T	HY585D	HY585H
胶料颜色A/B	无色透明	无色透明	白色/灰色	白色/灰色
密度(g/cm ³)	0.95~1.05	0.95~1.05	1.3~1.5	1.3~1.5
粘度(Pa.S)	0.5~1.0	0.5~1.5	2.5~5.5	2.5~6.5
可操作时间(min)	60~120	60~90	60~90	60~90
完全固化时间(h)	24	24	24	24
固化时间(60℃, min)	40	40	40	40
邵氏硬度 (Shore A)	/	30~65	30~65	30~65
剪切强度 (MPa)	/	0.8	0.8	0.8
导热系数 (W/m·k)	/	0.3	0.7	1.2
阻燃等级 (UL94)	/	HB	V0	HB
介电强度 (kv/mm)	≥18			
体积电阻 (Ω·cm)	≥1.0×10 ¹⁴			
适用温度 (℃)	-60~200			

※注：所有机械性能和电性能均在25℃、湿度55%条件下固化7天后所测。



双组份聚氨酯灌封胶

特点用途

双组份、室温固化、硬度可调的聚氨酯材料，流动性好，常温固化，固化后成弹性橡胶体。具有极佳的耐高低温、耐水解稳定性和优异的绝缘性能。对灌封后的电器零件具有固定、绝缘、散热、防爆、保密等多种功能。适用于高压、高频、湿热环境及水下仪器、仪表等电子元器件的灌封浇注粘接、密封。

摄影艺术

1. 将密封处清理干净，无油、无水、无杂物。
2. 将A、B组分取出，放入混合罐中，充分搅拌均匀（搅拌均匀把空气搅入胶中）。最好抽真空，搅拌2分钟。胶量不宜超过容器的1/2，否则在固化时胶会收缩。
3. 将混合好的胶，慢慢倒入要灌封的器件内。冬季施工作业，如果环境温度低于5℃最好将A、B组分都预热至15℃左右。
4. 灌封好的工件于室温下固化，表干后方可进入下道工序，完全固化需要1天。夏季温度高，固化会快一些；冬季温度低，固化会慢一些。

注意事项

- ◆ A组分长时间放置若有沉淀或分层，应搅拌均匀后使用；B组分低温下容易结晶，应提前放置温度较高室内使其溶化，不影响产品性能。
- ◆ 混合好的胶应一次用完，未用完的A、B两组份分别密封保存。
- ◆ 密封贮存于阴凉干燥处，贮存期六个月。



主要技术指标

性能指标		HY981	HY982	HY983	HY984	HY985
固化前	A组分外观	白色流体				
	B组分外观	黄色液体				
	粘度 (MPa·S) (A/B)	5000-8000/300-380				半流淌
混合后粘度 (MPa·S)				3000-5000		半流淌
可操作时间 (min)		≤30	30-45	45-60	45-60	30-60
初步固化时间 (h)		3-5	5-7	8-10	8-10	3-6
完成固化时间 (h)		24	36	48	48	24
固化后	邵氏硬度 (shore A/D)	≥80D	80±10A	60±10A	40±10A	80±10A
	比重 (g/mm³)	1.5-1.7				
	线收缩率 (%)	0.3				
	工作温度范围 (℃)	-60~150				
	介电强度 (kv/mm)	≥25				
	体积电阻 (Ω·cm)	1.0×10 ¹⁵				
	导热系数 (W/M·K)	≥0.6				
剪切强度 (MPa)		≥3.5	≥2.3	≥1.5	≥0.8	≥4.5

双组分环氧灌封胶

特点用途

华宇环氧灌封胶是一类双组分、自流平、室温固化的环氧树脂灌封材料，具有优良的耐老化性、防潮性、电气绝缘性，高硬度和高击穿电压。适用于电子元器件的各种浇注粘接、密封。

HY484T透明型灌封胶

适用于数码管的常温灌封。

HY484P通用型灌封胶

用于一般电子元器件灌封和线路板封闭保护。

HY484L低粘度灌封胶

适用于对流动性要求高的线路板灌封。

HY484D导热阻燃灌封胶

用于对散热及阻燃要求较高的元件和线路板的灌封保护。

HY484HTR耐高温灌封胶

用于耐高温工况的零部件精密灌封、密封。

操作工艺

- 1.将被灌封处清理干净，无油、无水、无杂物。
- 2.将A组分搅拌均匀，按配比称取A组分和B组分，放入混合罐中，充分搅拌混合均匀。最好抽真空脱泡10分钟左右，配胶量不宜超过容器的1/2，否则在脱泡时胶会溢出。
- 3.将混合好的胶料尽快灌注到需要灌封的产品中。
- 4.灌封好的工件于室温下固化，完全固化需要1~2天。夏季温度高，固化会快一些；冬季温度低，固化会慢一些，在60℃保温2~3小时即可装配。

注意事项

- ◆ A组分若有沉淀或分层，应搅拌均匀后使用，不影响产品性能。
- ◆ 混合好的胶应一次用完，未用完的胶料和固化剂应密封保存。
- ◆ 密封贮存于阴凉干燥处，贮存期六个月。
- ◆ 包装规格：484T为30kg/套，其它为12kg/套。

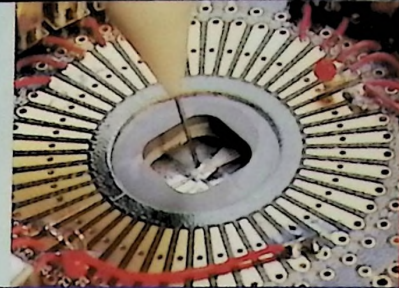


主要技术指标

性能指标		HY484T	HY484P	HY484L	HY484D	HY484HTR
固化前	外观颜色 (A/B)	透明液体	黑色/褐色	黑色/褐色	黑色/褐色	黑色/透明
	粘度 (Pa·S, A/B)	4 / 0.7	18 / 0.1	12 / 0.1	18 / 0.1	45 / 0.1
	密度 (g/cm ³ , A/B)	1.1 / 1.0	1.6 / 1.1	1.5 / 1.1	1.8 / 1.1	1.8 / 1.1
	重量配比 (A:B)	2:1	5:1	5:1	5:1	5:1
	可操作时间 (min)	30	60	60	60	60
	完全固化时间 (h)	48	48	48	48	48
固化后	邵氏硬度 (S.D)	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80
	线收缩率 (%)	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5
	导热系数 (W/M·K)	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7
	阻燃等级 (UL94)	HB	V0	HB	V0	V0
	介电强度 (kv/mm)	≥25				
	体积电阻 (Ω·cm)	1.2 × 10 ¹⁴				
	使用温度范围 (℃)	-40~90				-40~150

※注：所有机械性能和电性能均在25℃、湿度55%条件下固化7天后所测。

增韧快固环氧胶



特点用途

HY485增韧环氧胶为双组分1:1配比、10分钟快速固化胶，凝胶无烟化、柔韧，具有优良的耐老化性、防潮性、电气绝缘性，弹性抗震和高击穿电压。适用于电子元器件的各种浇注粘接、密封、灌封。

HY485T增韧快固环氧胶

透明，用于金属、陶瓷、塑料、玻璃、纤维制品、工艺品、宝石等的快速粘接固定。

HY485B增韧快固环氧胶

灰黑色，用于新能源电池、变压器、线圈、磁芯等电子元器件的粘接、密封、灌封。

操作工艺

前期准备

保证灌封表面清洁、干燥。长期存放由于比重大容易分层，用前应搅拌均匀再使用，以保证产品性能。

混合胶液

将固化剂B按比例加入胶料里，边搅拌边倒入，注意要刮壁，搅拌均匀、颜色一致为好。

混合好的胶液应在5分钟内用完。

可采用自动混料灌装！

注意事项

- ◆若有沉淀或分层，应搅拌均匀后使用，不影响产品性能。
- ◆混合好的胶应一次用完，未用完的胶料和固化剂应密封保存。
- ◆密封贮存于阴凉干燥处，贮存期六个月。
- ◆包装规格：400ml/组，20kg/套。



主要技术指标

性能指标		HY485T	HY485B
固化前	外观颜色 (A/B)	透明	灰黑色
	粘度 (Pa·S, 23℃)	15~50	25~60
	密度 (g/cm³, 23℃)	1.05±0.2	1.5±0.2
	体积配比 (A:B)	1:1	1:1
	可操作时间 (min, 23℃)	5	5
	初固时间 (min, 23℃)	10~15	10~15
固化后	邵氏硬度 (S.D)	75~85	75~85
	剪切强度 (MPa)	15~25	15~25
	延伸率 (%)	5~20	5~20
	阻燃等级 (UL94)	HB	V0
	使用温度范围 (℃)	-50~120	-50~120

※注：所有机械性能和电性能均在25℃、湿度55%条件下固化7天后所测。



单组份环氧灌封胶

特点用途

华宇单组份环氧灌封胶为加热固化单组份环氧胶。具有储存稳定，粘接强度高，绝缘性能良好，较双组份使用方便，适用性强等特点。适用于继电器、电容器、触发器、IC电路以及计算机、电视机、冰箱、汽车、摩托车等各类电子元器件的灌封。

使用方法

- 1.将胶从冰箱拿出，放在室温与外界平衡1~2小时。
- 2.将胶液手工或机械灌入需封装的元器件内或表面。
- 3.缓慢升温加热固化，有利于气泡逸出和胶液渗透填充缝隙，确保各项性能优良。
- 4.用毕，应及时盖好盖，并放入冰箱5℃下保存。

注意事项

- ◆本品于5℃下贮存有效期为3个月，超过贮存期若粘度合适仍可使用。
- ◆应根据实际固化条件，被加工元件的特性进行固化试验，以确定适合于特定产品的最佳固化条件。
- ◆本品为非危险品，按非危险品储存及运输。
- ◆包装规格：1KG。

5521单组份环氧灌封胶

表面光泽可为亮光或者哑光，颜色可为白色或者黑色，粘度低，适用于较小狭缝的灌封，120℃条件下30分钟固化。

5522单组份环氧灌封胶

无色透明，表面效果好，100℃条件下60分钟固化。

5523单组份环氧灌封胶

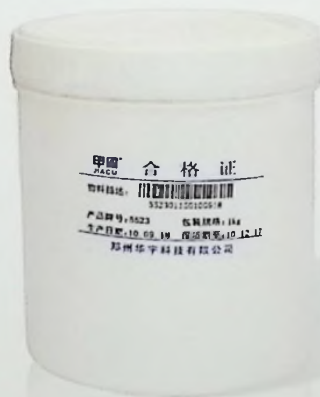
表面光泽可为亮光或者哑光，颜色可为白色或者黑色，流平效果好，适用于手工点胶或者机器自动点胶，100℃条件下30分钟固化。

5524单组份环氧灌封胶

黑色自流平，80℃下90分钟固化，适用于低温固化。

5526单组份环氧灌封胶

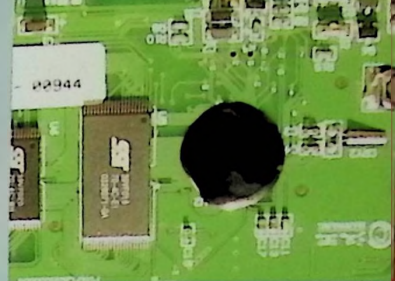
表面光泽可为亮光或者哑光，颜色可为白色或者黑色，流平效果好，适用于手工点胶或者机器自动点胶，120℃条件下30分钟固化。



主要技术指标

项 目	5521	5522	5523	5524	5526
外观	白色或黑色	无色	白色或黑色	黑色	白色或黑色
粘度 (mPa.s, 25℃)	3000	5000	10000~20000	20000	30000~40000
密度 (g/cm³)	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4
固化条件	120℃30分钟	100℃60分钟	100℃90分钟	80℃90分钟	120℃30分钟
硬度 (shore D)	80	80	83	80	83
剪切强度 (钢/钢, Mpa)	13	13	15	13	15
体积电阻率 (Ω·cm, 25℃)	1.3×10^{15}	1.3×10^{15}	1.5×10^{15}	1.3×10^{15}	1.5×10^{15}
表面电阻率 (Ω, 25℃)	1.2×10^{15}	1.2×10^{15}	1.3×10^{15}	1.2×10^{15}	1.3×10^{15}
耐电压 (25℃kV/mm)	20~22	20~22	20~22	20~22	20~22
抗张强度 (kg/mm²)	11	11	13	11	13
抗压强度 (kg/mm²)	13	13	15	13	15
收缩率	<0.5%	<0.5%	<0.5%	<0.5%	<0.5%
玻璃化转变温度 (℃)	140	140	150	140	150

单组份环氧邦定胶



特点用途

华宇单组份环氧包覆胶为加热固化单组份环氧胶。具有储存稳定，粘度适中，绝缘性能良好，粘接性能高，较双组份使用方便等特点。适用于金属、线圈以及电机等部件的邦定、密封。

5515单组份环氧包覆胶

5515单组份环氧包覆胶为加温固化单组份环氧胶黏剂，亮光，主要用于金属、线圈等器件的包覆、密封。

5516单组份环氧邦定胶

5516单组份环氧邦定胶为加温固化单组份环氧胶黏剂，亮光，主要用于IC芯片、线路板等电子元器件的邦定、密封。

使用方法

- 1.将胶从冰箱拿出，放在室温与外界平衡1~2小时。
- 2.将胶点在基板上。若胶的粘度较高，可先将胶预热40~50℃后涂胶，也可不预热使用。
- 3.升温加热固化。
- 4.用毕，应及时盖好盖，并放入冰箱5℃下保存。

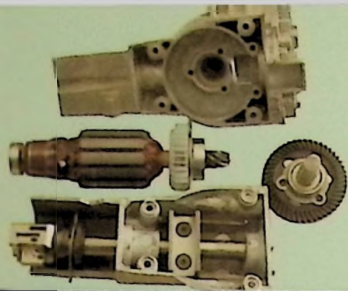
注意事项

- ◆本品于5℃下贮存有效期为3个月,超过贮存期若粘度合适仍可使用。
- ◆应根据实际固化条件，被加工元件的特性进行固化试验，以确定适合于特定产品的最佳固化条件。
- ◆本品为非危险品，按非危险品储存及运输。
- ◆包装规格：1KG。



主要技术指标

项 目	5515	5516
外观	黑色/白色粘稠物	黑色粘稠物
密度 (g/cm ³)	1.5	1.5
粘度 (Pa.s, 25℃)	80	100~150
固化条件	120℃30分钟	120℃30分钟
剪切强度 (钢/钢, Mpa)	18	18
体积电阻率 (Ω*cm, 25℃)	1.4×10^{15}	1.4×10^{15}
介电强度 (kv/mm, 25℃)	>20	>20
介电常数 (1MHz, 25℃)	4	4
线膨胀系数 (cm/℃)	$<5 \times 10^{-5}$	$<5 \times 10^{-5}$
硬度 (shore D)	83~85	83~85
收缩率	<0.15%	<0.15%
玻璃化转变温度 (℃)	150	150



单组份环氧结构胶

特点用途

华宇单组份环氧结构胶为中高温固化单组份环氧胶。具有储存稳定，粘接强度高，绝缘性能良好，较双组份使用方便，固化时具有触变性，适用性强等特点，固化物可以是黑色或白色固体。适用于金属、塑料、玻璃、电机等材质的粘接。

5531单组份环氧结构胶

白色触变性膏状

5532单组份环氧结构胶

黑色触变性膏状

使用方法

- 1.将胶从冰箱拿出，放在室温与外界平衡1~2小时。
- 2.将胶涂布于需粘接的器件上两面贴合。
- 3.升温加热固化。
- 4.用毕，应及时盖好盖，并放入冰箱5℃下保存。

注意事项

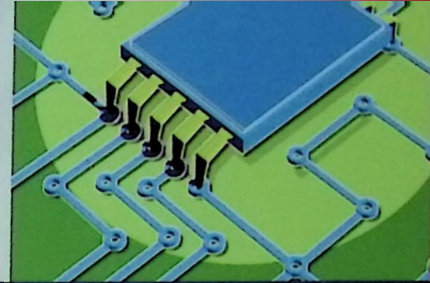
- ◆本品于5℃下贮存有效期为3个月,超过贮存期若粘度合适仍可使用。
- ◆应根据实际固化条件，被加工元件的特性进行固化试验，以确定适合于特定产品的最佳固化条件。
- ◆本品为非危险品，按非危险品储存及运输。
- ◆包装规格：300ml/筒，25筒/箱。



主要技术指标

项 目	5531	5532
外观	白色触变膏状	黑色触变膏状
粘度 (Pa.s, 25℃)	80-150	80-150
固化条件	120℃30分钟	120℃30分钟
剪切强度 (钢/钢, Mpa)	21	21
体积电阻率 ($\Omega \cdot \text{cm}$, 25℃)	1.5×10^{15}	1.5×10^{15}
表面电阻率 (Ω , 25℃)	1.2×10^{15}	1.2×10^{15}
抗张强度 (kg/mm^2)	13	13
抗压强度 (kg/mm^2)	15	15
收缩率	<0.5%	<0.5%
硬度 (shore D)	83	83
热变形温度 (℃)	>150	>150

SMT环氧贴片红胶



5541贴片胶是根据SMT表面贴装技术工艺要求而研制的单组份环氧胶，具有很好的胶点控制能力，特别适用于手动或者自动印刷工艺。

产品特点

1. 固化快。
2. 非溶剂型，适用范围广。涂敷时，微少量涂敷仍可保持无拉丝，拖尾，塌陷现象，胶点稳定性好。
3. 极小面积涂敷，在极短时间内固化下均不容易造成气泡或粘力不够。
4. 具有优良的耐热性和电气特性。

固化条件

◆ 推荐固化条件150℃90~120秒或者120℃160~180秒，最高固化温度不超过200℃。

使用方法

1. 将胶从冰箱拿出，放在室温与外界平衡1~2小时。
2. 采用刮胶或点胶工艺，将胶涂在已洁净的印刷线路板表面。若用于粘接，需要将两个被粘物均涂上该胶。
3. 升温加热固化。
4. 用毕，应及时盖好盖，并放入冰箱5℃下保存。

注意事项

- ◆ 产品适用的印刷速度为20~150mm/s,工艺随所选产品和印刷机设置的不同而改变
- ◆ 最佳的印刷条件为温度25℃相对湿度不超过70%。
- ◆ 应根据实际固化条件，被加工元件的特性进行固化试验，以确定适合于特定产品的最佳固化条件。
- ◆ 未固化胶黏剂可用异丙醇、丙酮、丁酮或酯类溶剂清洗。
- ◆ 本品自生产之日起，于5℃~10℃贮存，有效期为3个月。超过贮存期，若粘度合适，仍可使用。
- ◆ 本品为非危险品，按非危险品储存及运输。
- ◆ 包装规格：310ml/筒。



主要技术指标

项 目	5541
外观	红色膏状
粘度 (Pa.s, 25℃)	500~700
密度 (g/cm ³)	1.25
剪切强度 (钢/钢, Mpa)	15
硬度 (shore D)	85
表面电阻率 (Ω, 25℃)	>2.1×10 ⁵
体积电阻率 (Ω·cm, 25℃)	5×10 ¹⁴
介电常数 (1MHz, 25℃)	3.2

- 本产品样本中提供的技术参数仅供参考，它们会随不同的工况条件而改变。
如设备类型、材质、工艺条件、环境温度湿度等都会影响其性能。
- 用户在使用前，要做好粘结性、相容性实验，自行决定产品的适应性，我司对任何意外所造成的损失概不负责。



瑞朗达公众号



瑞朗达视频号



瑞朗达抖音号

工业胶查阅 www.huayukeji.com
建筑胶查阅 www.ralead.com

郑州华宇科技有限公司
河南瑞朗达新材料有限公司

生产基地：河南省宝丰高新区 营销中心：郑州市农业路22号
销售热线：0371-65336633 0375-3360080
[http : www.huayukeji.com](http://www.huayukeji.com) www.ralead.cn
E-mail : kjh@ralead.cn

特约经销商